

投資家向け説明資料

浜井産業株式会社(証券コード:6131)

2024年5月28日

投資家向け説明資料策定の背景

私ども浜井産業は1921年の創業以来、高精度・高品質の工作機械を製造・販売して参りました。日本で最初に当社が製造したラップ盤・ポリッシュ盤(研磨加工機)ならびに、創業時から作り続けている小型ホブ盤(小型歯車加工機)は、その形は変わっても、現在でも当社の主力製品でございます。

今般、コロナ禍からの経済活動の再開に伴い、工作機械の受注が回復しつつあることや、世界的なEV化の流れに伴い、次世代半導体の需要が急速に高まっていることなど、当社を取り巻く環境は大きく変化しております。

当社は、これらの経営環境の変化を当社の企業価値向上の好機と捉え、変化に適応し、より一層の成長と発展を目指すべく、この度、中長期的な経営戦略を推進しております。

当社といたしましては、引き続き事業活動を通じた成長戦略を講じつつ、資本市場との対話を深め、投資家・株主の皆様のご期待に応えるよう、企業価値最大化に取り組む所存でございます。

当社経営にご理解いただき、皆様のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2024年5月28日
浜井産業株式会社
代表取締役社長 武藤 公明

INDEX

1 当社の経営戦略について

- 会社概要
- 当社を取り巻く環境
- 事業戦略・資本戦略・サステナビリティ

2 2024年3月期 決算概要

3 2025年3月期 通期業績予想

INDEX

1 当社の経営戦略について

■ 会社概要

- 当社を取り巻く環境
- 事業戦略・資本戦略・サステナビリティ

2 2024年3月期 決算概要

3 2025年3月期 通期業績予想

企業 理念

ゆるぎない品質の精密機械で産業の発展に貢献する

当社ビジネスの概要

1

ラップ盤

究極の平面を作り上げる

当社のラップ盤は、IT産業の一端を担うラップ盤として、究極の平面を作り上げるためにさまざまな機構を搭載しております。



3

フライス盤

四側面加工を全て自動化

金型用モールドベース等の四側面加工を全て自動化しました。対向ヘッド固定による両面同時加工は、確実な平行度を実現します。



2

ホブ盤

小型歯車の高精度化をリード

当社のホブ盤は、完成された名機として世界各国で活躍しております。小型ホブ盤の代名詞として、小型歯車の高精度化をリードしています。



4

歯車・部品

高精度歯車・部品を販売

歯車研削盤、ラック・ねじ研削盤といった特殊機械により、高精度歯車を製造しています。素材から完成までの工程には厳しいチェックのもとに作業が進められ、ご満足頂ける製品をお届け致しております。



創業100年の工作機械メーカー



売上高

2024年3月期

87.6億円

営業利益

2024年3月期

8.6億円

ROE

2024年3月期

23.7%

創業

1921年

従業員数

2024年3月期

115名

半導体シリコンウエハーのラップ工程



シェアNo.1

企業概要

社名 浜井産業株式会社 HAMAI CO.,LTD.

創業 1921年

設立 1938年

取引所 東証スタンダード市場（証券コード：6131）

代表者 代表取締役社長 武藤 公明

事業所

- 本社-
- 東京都品川区西五反田5丁目5番15号
- 営業本部・東京営業部・海外営業部-
- 東京都品川区西五反田5丁目5番15号
- 東日本営業部-
- 栃木県足利市福富新町1480
- 大阪支店-
- 大阪府東大阪市荒本北2-6-17
- 足利工場-
- 栃木県足利市福富新町1480

子会社

- ハマイエンジニアリング株式会社
- 東京都品川区西五反田5丁目5番15号

- 哈机械商貿(上海)有限公司
- 上海市虹橋路808号加華商務A-8-423室

代表者 代表取締役社長 武藤 公明

従業員 115名(連結)

事業内容 ラップ盤、ホブ盤、フライス盤、レンズ加工機、マシニングセンタ、その他の工作機械の製造販売

沿革

- 1938年1月 ● 株式会社浜井機械器具製作所を設立、工作機械の製造、販売を開始。
- 1946年3月 ● 浜井産業株式会社に商号を変更。
- 1963年7月 ● 東京証券取引所市場第二部に上場。
- 1964年9月 ● 大阪証券取引所市場第二部に上場。
- 1969年10月 ● 栃木県足利市に足利工場を新設。
- 1975年9月 ● 本社工場を閉鎖し足利工場へ統合。
- 1993年8月 ● 子会社 浜井エンジニアリング株式会社を設立。
- 1996年3月 ● 子会社 浜井エンジニアリング株式会社に足利工場を譲渡。
- 1999年4月 ● 子会社 浜井エンジニアリング株式会社を吸収合併。
- 2002年5月 ● 名古屋支店を大阪支店へ統合。
- 2003年5月 ● 大阪証券取引所市場第二部の上場廃止。
- 2006年9月 ● 子会社 ハマイエンジニアリング株式会社(現連結子会社)を設立。
- 2012年2月 ● 子会社 哈邁机械商貿(上海)有限公司(現連結子会社)を設立。
- 2018年3月 ● 子会社 哈邁机械商貿(上海)有限公司(現連結子会社)の出資持分を追加取得により完全子会社化。
- 2022年4月 ● 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行。

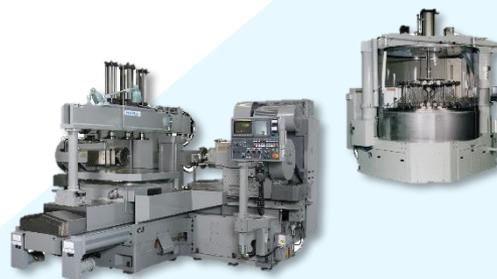
直径300mm半導体シリコンウエハのラップ工程において シェアNo.1

01 商品提案力



素材に合わせた製品開発や最適なスラリー等の組み合わせ(レシピ)を提案。お客様のニーズに合った製品やサービスを常にタイムリーにご提供

02 高品質な工作機械



高品質にこだわる企業文化
創業来の歯車製造機械づくりで築いてきた精密加工技術を活かし、高精度の加工機械を製造・販売

03 高い技術力



長年培われた技術
創業来の多数の取引実績からノウハウを蓄積

部品・歯車

21.8%



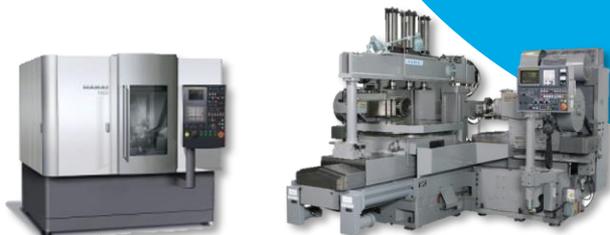
ラップ盤
66.5%



87.6 億円
(2023年4月～2024年3月)

ホブ盤・フライス盤

11.6%

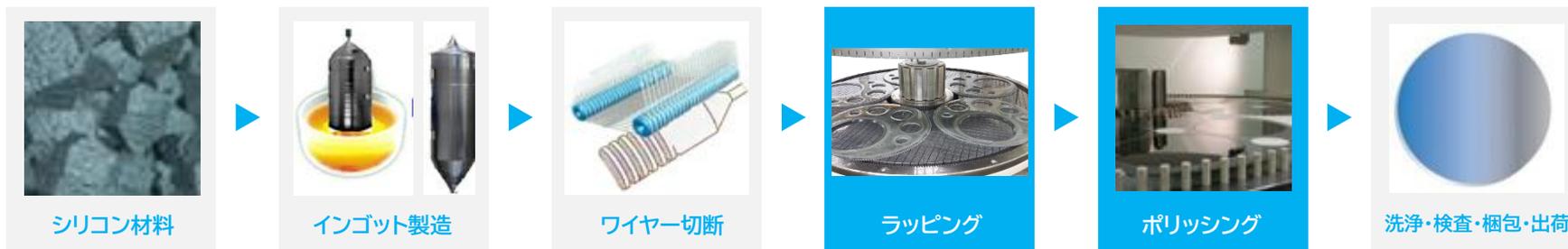


究極の平面を作り上げる



32BN-Lシリコンウエー八仕様

半導体シリコンウエー製造工程



主な用途

半導体シリコンウエー製造工程においてラップ盤は、主にラッピングとポリッシングの2つの役割を果たし、半導体シリコンウエーの表面品質を向上させ、製造プロセスの信頼性と効率を向上させる重要な工作機械です。

ラッピング:

ラッピングは、ウエーの表面を研磨し、平坦化することで表面の微細な凹凸や不均一な部分を取り除きます。これにより、後段の半導体製造プロセスでより正確なパターン形成や薄膜堆積が可能になります。

ポリッシング:

ポリッシングは、ラッピングの後に行われる工程で、さらなるウエー表面の平滑化と光学的な仕上げを提供します。この工程により、ウエー表面の微細な凹凸がさらに取り除かれ、極めて平滑な表面が得られます。これにより、半導体デバイスの製造中に重要な薄膜の堆積やパターニングプロセスにおいて、より一貫した性能が得られます。

販売先主要業種

- ・半導体ウエー
- ・ガラスハードディスク基板
- ・水晶振動子
- ・各種光学部品材料等の加工業及び製造業
- ・自動車部品加工業

当社ラップ盤の特長

- ✓ 劈開性の強い材質および薄物加工に最適
- ✓ ハイエンド半導体のウエーのラップ加工を独占
- ✓ SiC・GaNなどの新素材ウエー加工にも採用多数

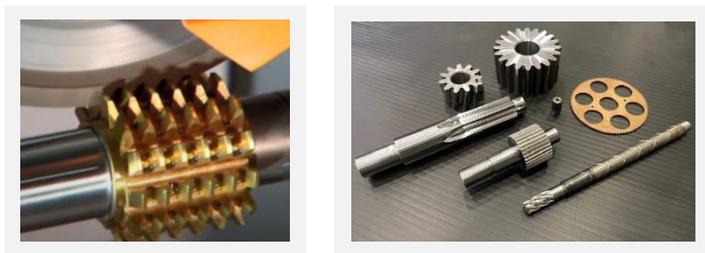


最先端半導体シリコンウエーのラップ工程における
世界シェア

No.1

小型歯車の高精度化で世界をリード

ホブ盤による歯車加工



- ・ ホブ盤は、ホブと呼ばれる特殊な切削工具を使用して、ワークピース(歯車の材料)を回転させながら押し付けることで、歯車の歯を形成します。
- ・ ホブの外周には、多数の切れ刃と溝がらせん状に配置されています。
- ・ ホブ盤は、少量多品種から大量生産まで、精度の高い歯車を効率よく生産できることから、歯車加工において広く使われています。

主な用途

工業製品にはさまざまな歯車が必要です。ホブ盤は、自動車、航空機、鉄道車両、産業機械など、さまざまな分野で使用される機械の歯車を製造するために使用され、少量多品種から大量生産まで、精度の高い歯車を効率よく生産できます。

販売先主要業種

・自動車部品加工業 ・減速機 ・電動工具 ・釣具 ・OA機器 等

当社ホブ盤の特徴

浜井産業創業まもない1936年(昭和11年)から生産を続けているホブ盤は、高精度加工で高い信頼性を誇るホブ盤として、世界各国で活躍しております

1

小型の歯車を
高精度に加工

2

加工プロセスの
自動化と高い制御性

3

エネルギー効率の
向上や廃棄物削減
などによる持続可能性



CNC横型ホブ盤 Nシリーズ

自動ホブ研削盤 GN150

INDEX

1 当社の経営戦略について

- 会社概要
- 当社を取り巻く環境
- 事業戦略・資本戦略・サステナビリティ

2 2024年3月期 決算概要

3 2025年3月期 通期業績予想

経営環境の変化をチャンスと捉え、更なる成長を目指す

マクロ・社会の変化

AIの発展

人工知能はまだ成長期の過程にあるものの、今後日本や世界が抱える社会課題を解決し、持続的な経済成長を支えるとともに、ますます多様な分野に進出しております。



世界規模の脱炭素・省エネの加速

地球温暖化による気候変動リスク、化学燃料の枯渇リスク等を背景として、2015年パリ協定以降、世界的な脱炭素・省エネの動きはますます加速しています。



EV関連の急成長

世界的な脱炭素・省エネの動きを背景として、電気自動車(EV)の普及が急速に進んでおり、世界各国でEVの販売台数が増加しています。今後もEVの市場は大きく拡大すると予想されています。



業界トレンド・課題

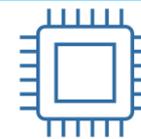
半導体需要の続伸

AIの発展に伴い、半導体製造装置関連の需要も増加の一途をたどることが予想されます。



次世代半導体需要の伸長

EVのモーターは高電圧・高電流の電力を制御する必要があります。このため、EVの市場拡大に伴い、高電圧・高電流に耐える能力のあるパワー半導体の需要も急速に増加しています。



パワー半導体:電力を制御・変換するために使用される半導体デバイスで、エネルギー効率の向上や電力の制御を可能にする重要な役割を果たしています。

半導体製造装置において東アジアが世界をリード

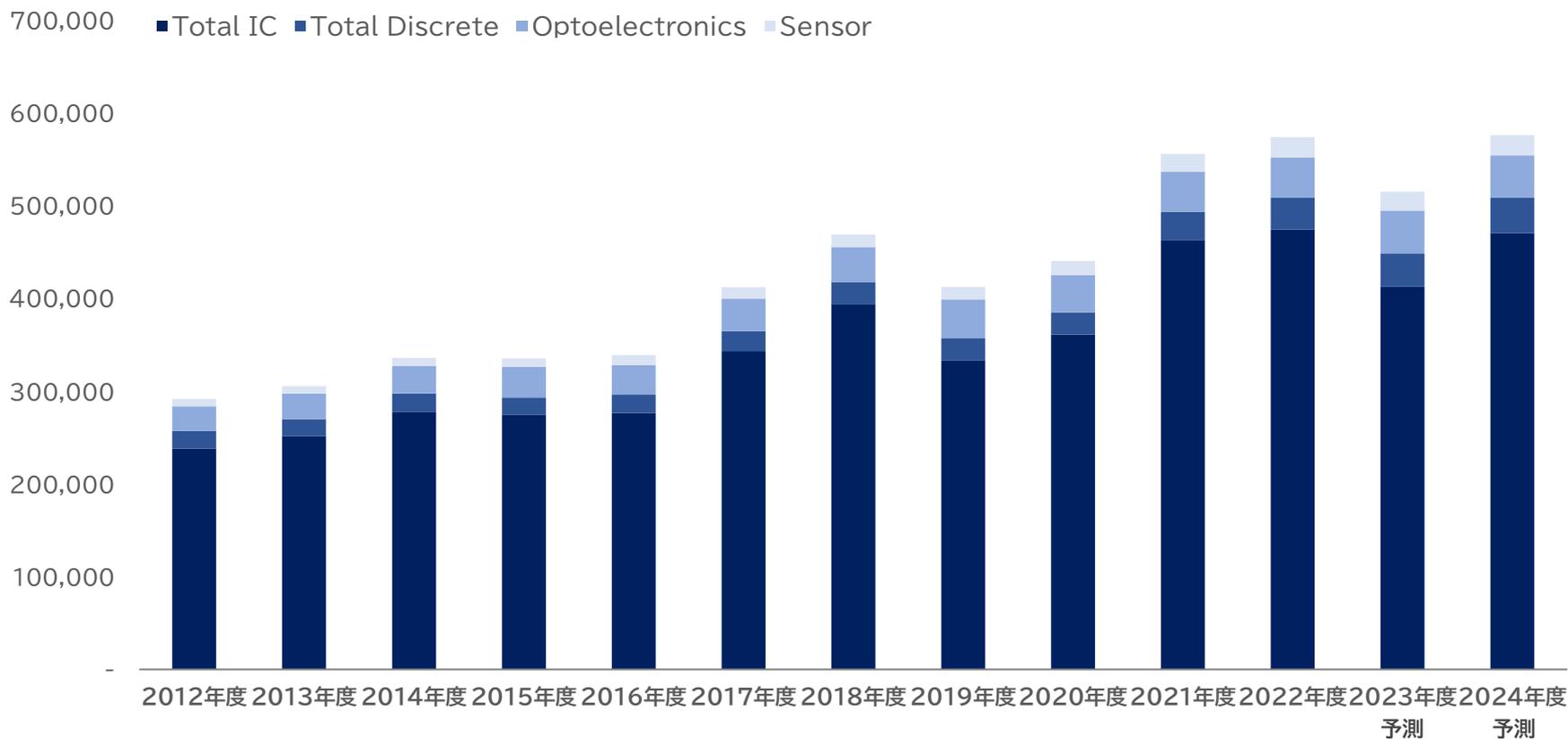
半導体製造装置市場において、人件費・地政学的要因により、特に台湾、韓国、中国、日本の東アジア地域の売上高が好調となっています。



世界の半導体市場規模は右肩上がりに推移 短期的な凹凸はあるが、長期的には今後も高水準での成長が見込まれる

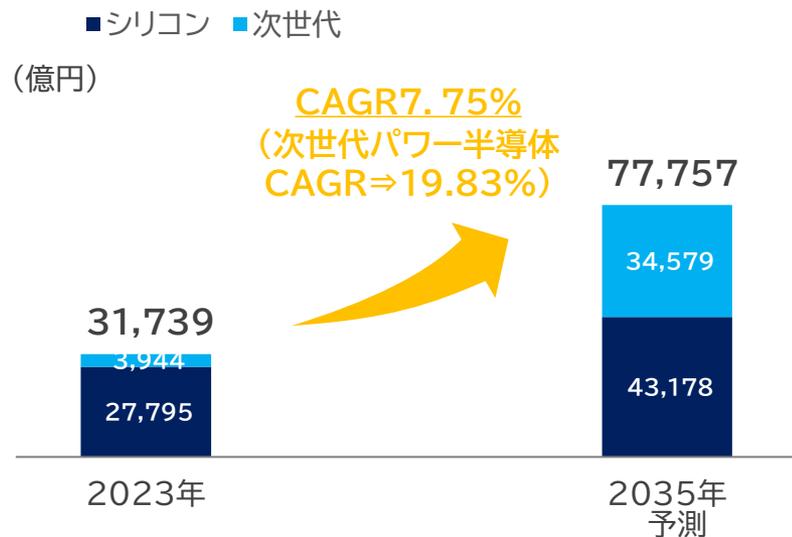
世界半導体市場予測

(百万ドル)



EV関連の成長により、パワー半導体は大きく伸長 今後は次世代パワー半導体の成長が高まるとみられる

パワー半導体の世界市場予測



次世代パワー半導体の世界市場予測

■ SiCパワー半導体

2023年	2035年予測	2023年対比
3,870億円	3兆1,510億円	8.1倍

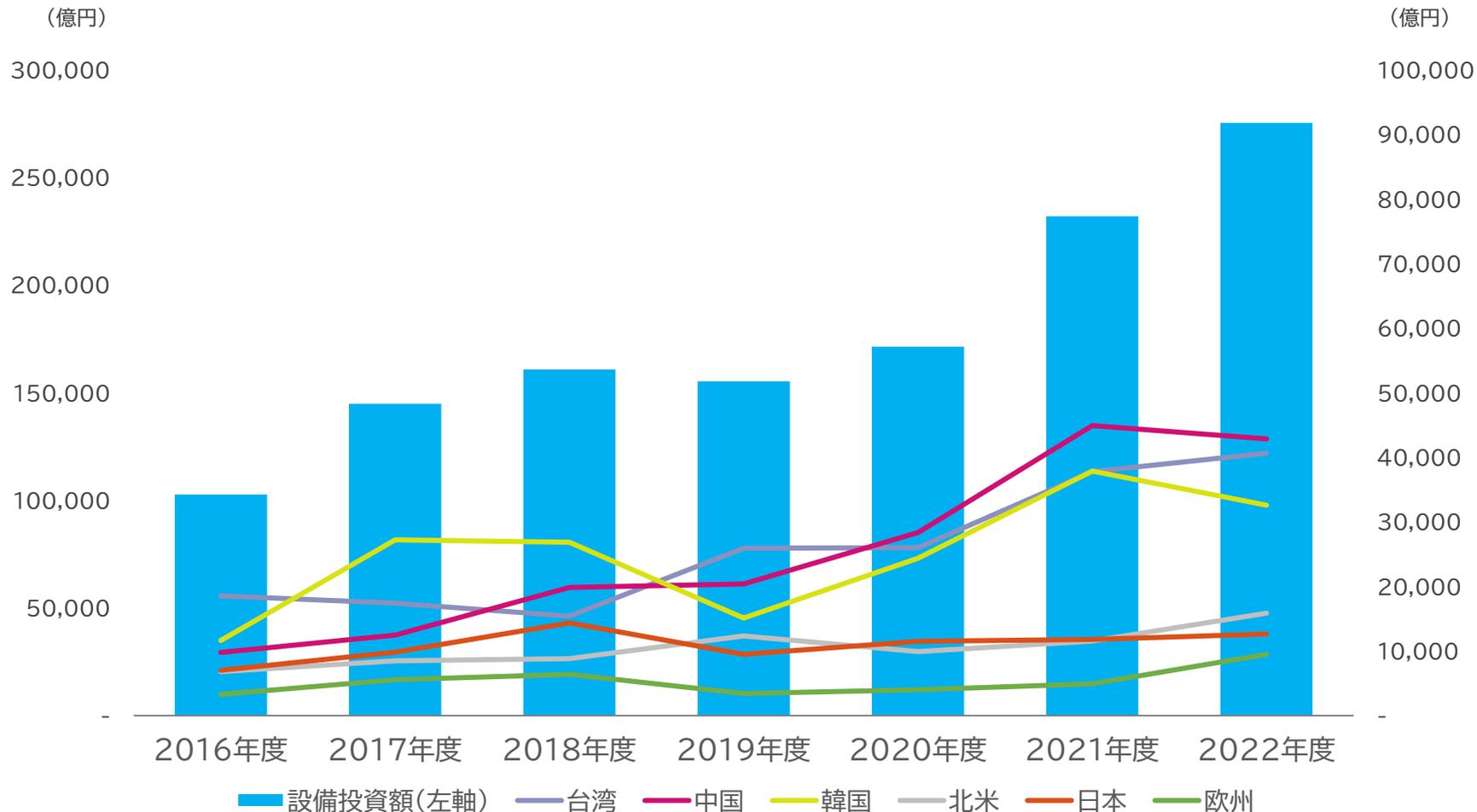
■ GaNパワー半導体

2023年	2035年予測	2023年対比
74億円	2,674億円	36.1倍

■ 酸化ガリウムパワー半導体

2023年	2035年予測	2023年対比
僅少	385億円	—

世界全体の半導体製造装置市場の設備投資額は2020年度以降に増加 特に台湾、韓国、中国、日本の東アジア地域の売上高が好調



INDEX

1 当社の経営戦略について

- 会社概要
- 当社を取り巻く環境
- 事業戦略・資本戦略・サステナビリティ

2 2024年3月期 決算概要

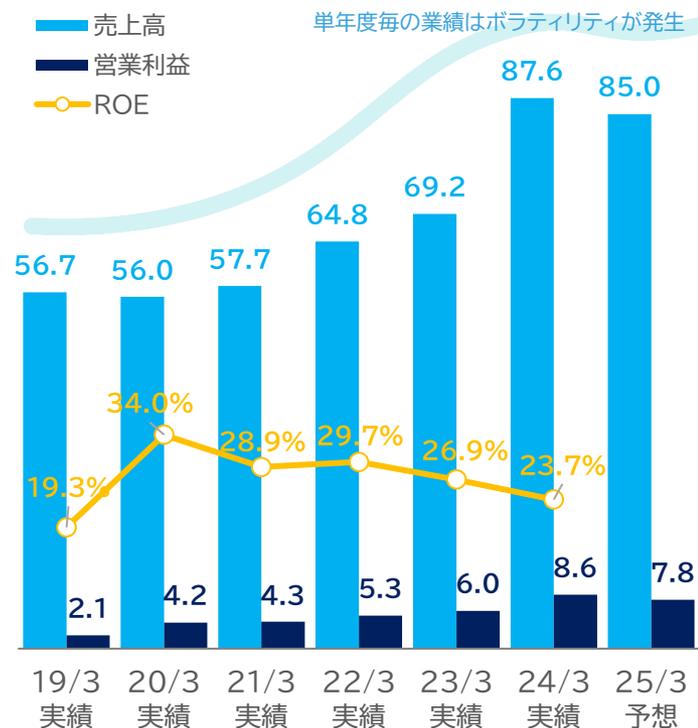
3 2025年3月期 通期業績予想

中長期的に売上高100億円、営業利益10億円を目指す

売上高・営業利益の推移

(億円)

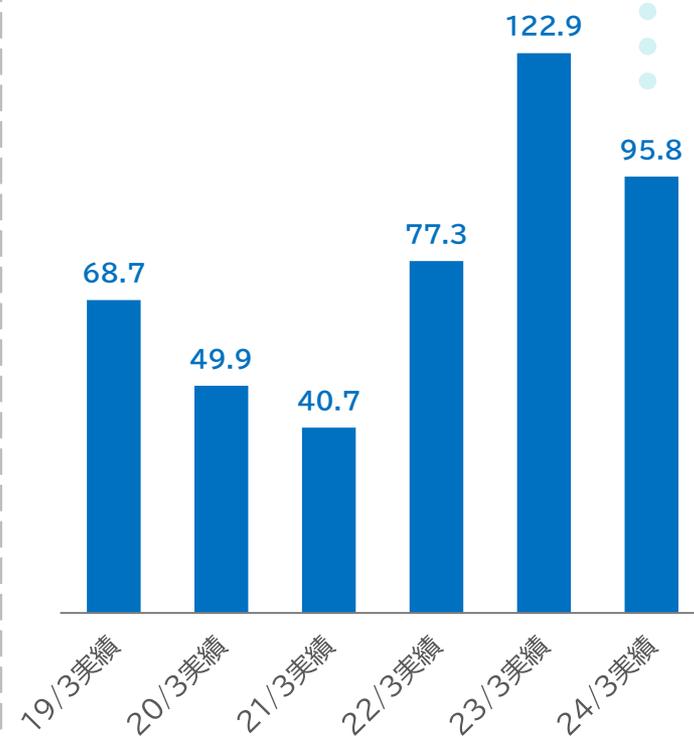
目指すべき姿



受注残の推移

(億円)

部材の逼迫に伴うリードタイムの伸びが影響し、既受注分のうち、25/3期売上高は85億円の着地予想



3つの基本戦略を軸に、売上高および営業利益の向上を目指す

基本戦略

トップラインの成長

1 製品ラインナップの拡充

- パワー半導体向けの新型ラップ盤の開発
- 製品開発部の組織体制強化
- 開発プロセスの効率化
- 開発人材の確保

2 販路拡大

- アジア市場、北米市場等の有力代理店網の組成
- 海外営業部門の人材拡充

売上**100**億円以上
2024年3月期対比 +14%

ボトムラインの向上

3 生産性の向上

- 原価率の低減(75%を目指す)
- 製造工程のマニュアル化
- DXの推進(ITの活用)
- 作業時間の短縮

営業利益**10**億円以上
2024年3月期対比 +16%

新製品の開発に積極的に取り組み、製品ラインナップを拡充

設計部門の組織改革

製品の販売までの流れ



設計部門の組織体制強化

設計部門の組織体制



取り組み

- 生産設計の一部をベトナム事務所に委託することで、開発設計に係る人材を確保
- 協力企業との連携も視野に開発人材の技術力の強化を図る
- 技術・ノウハウの若手社員への伝承(質の高い教育の提供、作業工程のマニュアル化)

当社の新製品

ラップ盤・ポリッシュ盤

パワー半導体ウエハー向け16BF

SiCやGaN、AINなどのパワー半導体向け新素材の加工に特化した新たなラップ盤を加工ノウハウと併せてご提供いたします。



ホブ盤

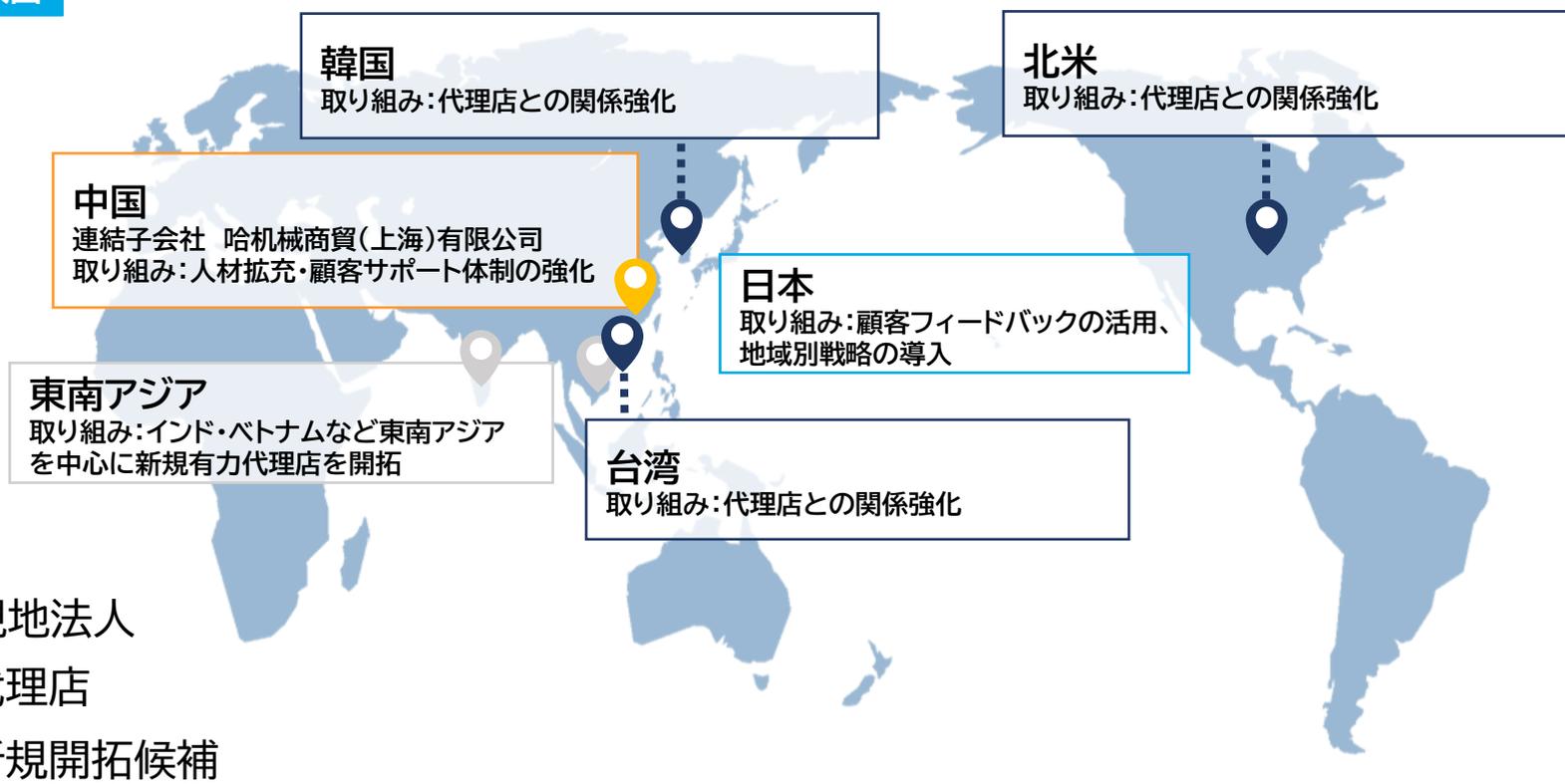
N70 N-series

N70は、EV向けの小型歯車に重点を置いた横型CNCホブ盤です。最大モジュール2.5まで対応可能で工具の最高回転数6,000min-1としており、ドライ切削も可能。自動化に対応したスラント形状です。

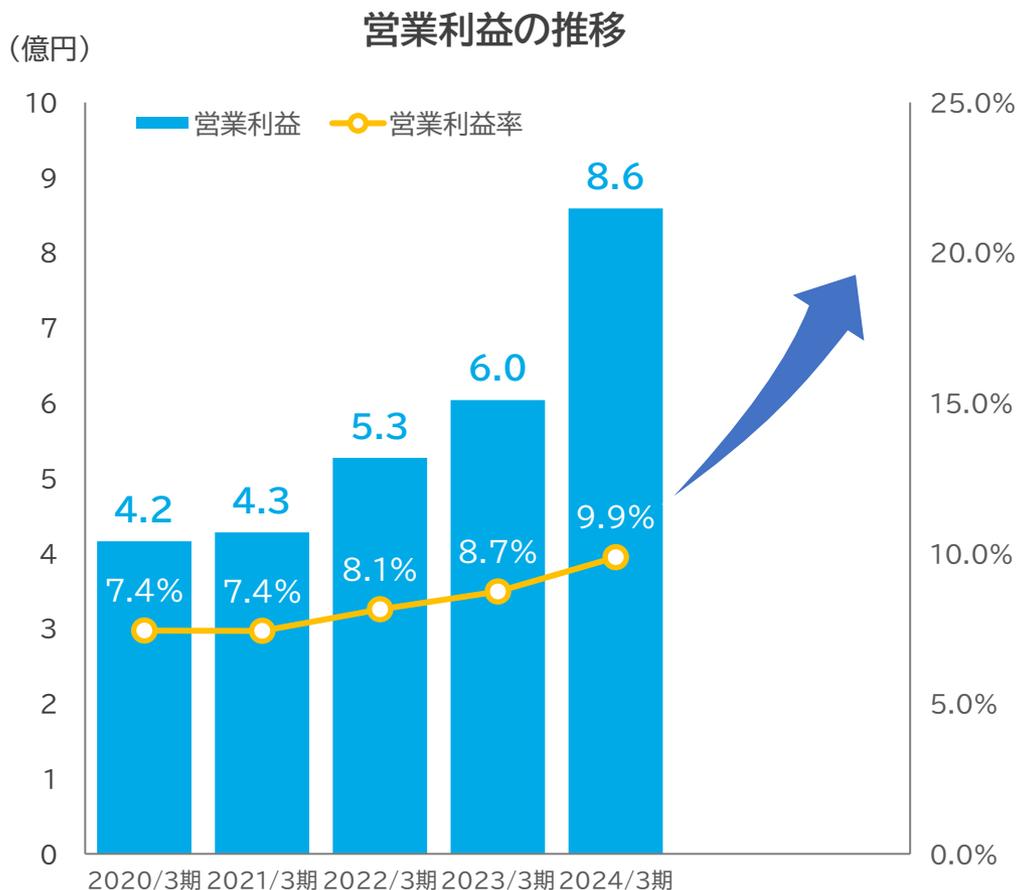


(単位:百万円)	2022/3	2023/3	2024/3	前期比(増減率)	
国内	2,131	3,188	3,997	809	(25.4%)
東アジア	3,063	2,902	4,458	1,556	(53.6%)
東南アジア	1,127	721	135	▲586	(▲81.3%)
その他	154	105	165	60	(57.1%)
合計	6,475	6,916	8,755	1,839	(26.6%)

販路拡大図



生産性の向上により営業利益10億円を目指す



主な取り組みと効果

適正な製品売価の見直し

- 市場環境を踏まえた価格設定の最適化
- 高付加価値製品の開発

製造工程のマニュアル化

- 作業者の作業効率アップ
- 欠陥やエラー発生率の低減
- 従業員のトレーニング時間の短縮

DXの推進(ITの活用)

- IoT化による製造ライン全体の効率化
- データの活用による生産性向上、品質管理強化

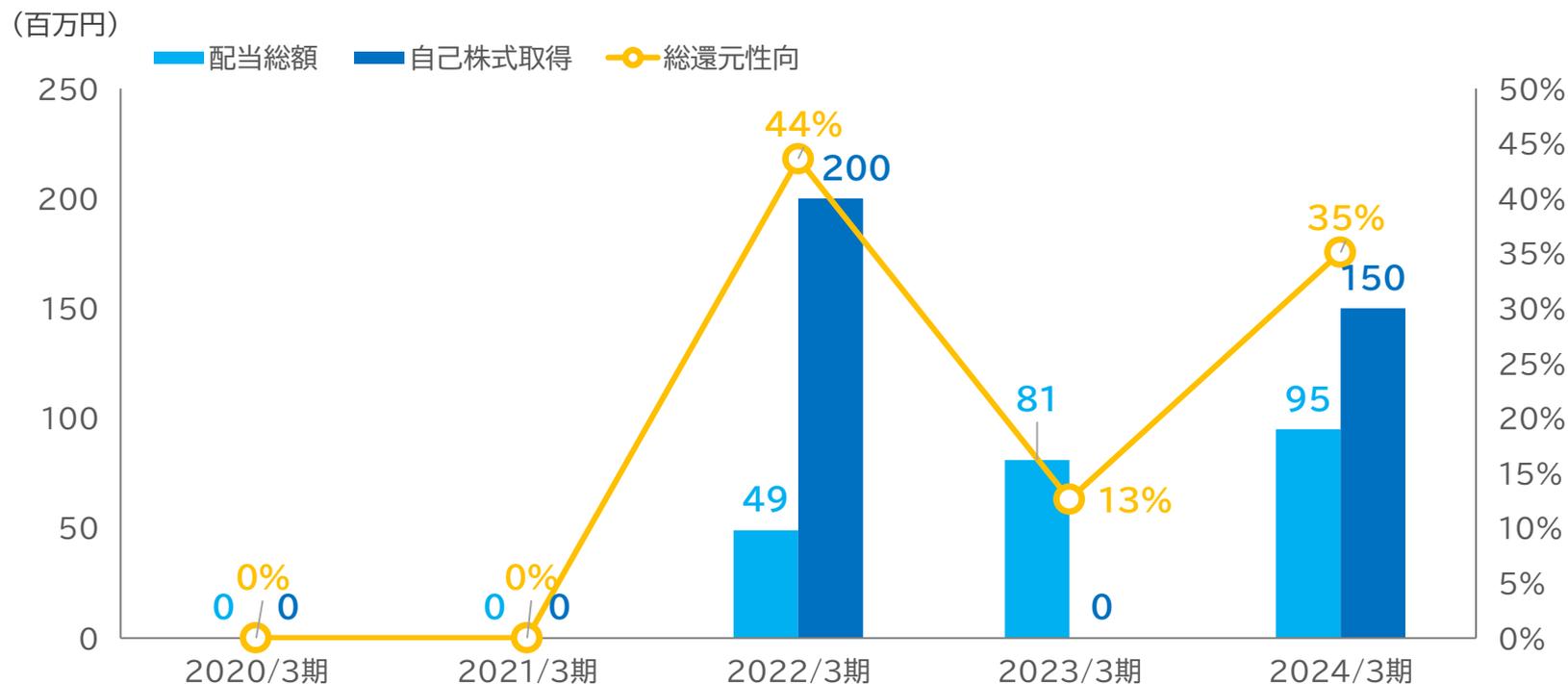
株主還元の基本方針

企業体質の強化及び今後の事業展開等を勘案したうえで、「業績・収益状況に対応した配当の実施」を目指す

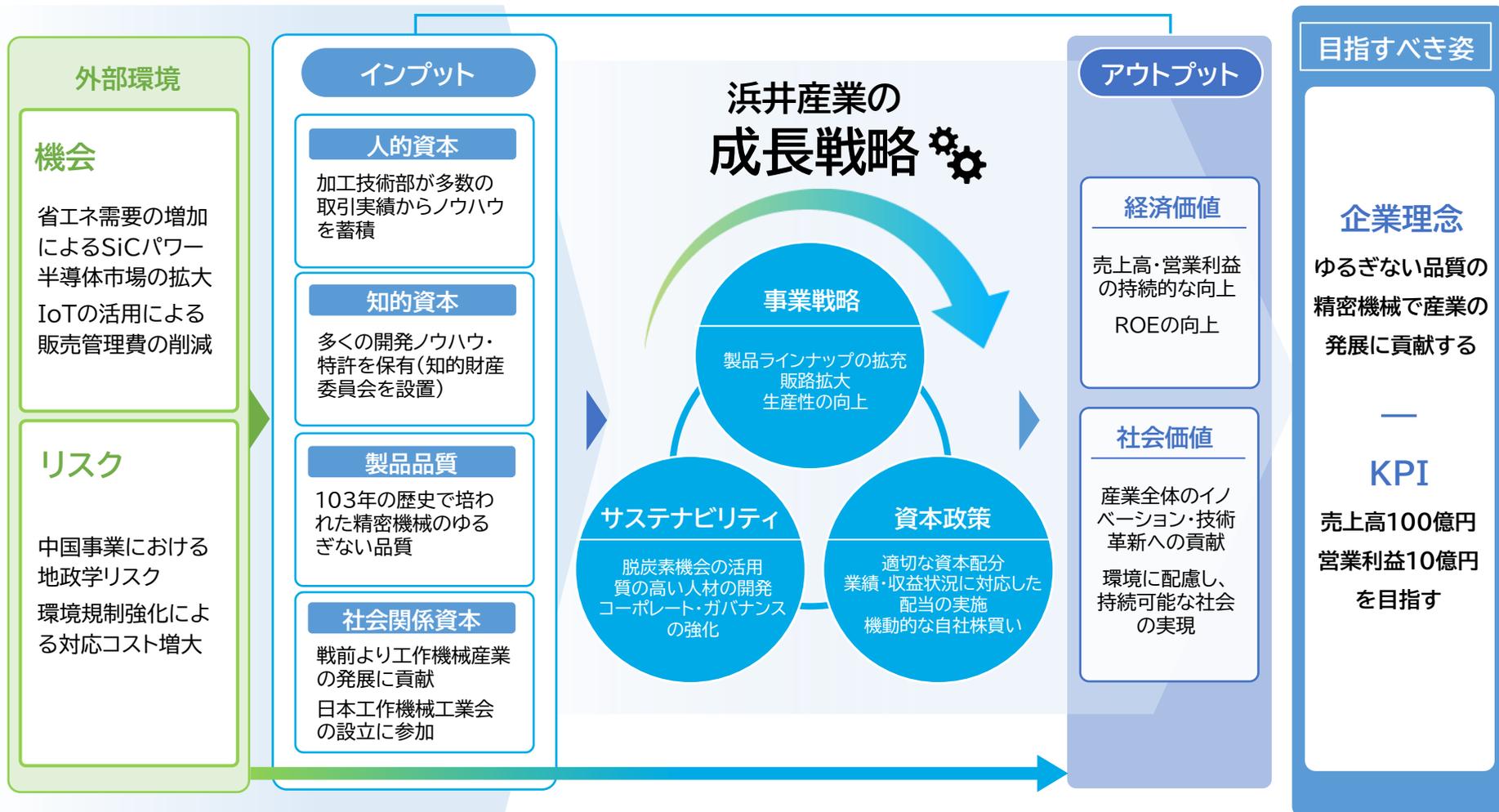
2024年3月期

年間配当金：1株当たり30円
 （前年比+5円）
 3期連続での増配を実施

年間配当金推移(直近5ヶ年)



成長戦略をベースとした価値創造プロセスにより、 ありたい姿の実現を目指す





環境保全への貢献

- 油水分離槽の点検による漏水予防
- 渡良瀬川クリーン運動への参加
- 工場の使用電力量の削減(工場内の照明器具をLED化)
- 工場内の窓に遮熱塗料を使用することによる冷暖房設備の使用電力削減
- 製品に使用する部材の不良率低減
- 全社的なペーパーレス化の推進
- 生産拠点の足利工場で使用するトルエン量の削減
- 分別回収の徹底による廃棄物の再資源化



環境マネジメント システムの継続的改善

- 環境マネジメントシステム ISO14001 2012.12.1 取得
- 品質マネジメントシステム ISO9001 2000.11.10 取得
(総合マネジメントシステムとして、本社、足利工場、大阪支店の全部門に適用)



脱炭素機会の活用

- SiC、GaNなどのパワー半導体素材を加工するラップ盤の開発
- エネルギー効率を最大限に高めた工作機械
- 切削油・廃棄物削減により環境にやさしい工作機械



地域・社会への貢献

地域貢献活動

- 工場周辺の清掃
- 足利の山クリーンハイクへの参加
- 栃木県足利警察署と足利地区職場警察連絡協議会(職警連)が主催した『地域安全運動ボランティア活動』に参加協力



足利の山クリーンハイクへの参加



質の高い教育の提供 による人材育成

採用

- 新卒採用と並行して経験者・中途採用を推進

育成

- 技術・技能(含むノウハウ)の伝承

多様性

- 入社時研修制度や人権研修など、多様性を受け入れるための研修等を実施
- 管理職26人のうち5名が中途(うち1名が外国人)

挑戦

- 従業員一人一人の生産性の向上
- 新しい技術やツールを習得など、技術の変化に対する迅速な適応



委員会

取締役会・監査等委員会

- 取締役会の独立社外取締役比率 37.5%
- 独立社外取締役のみで構成された監査等委員会
- 取締役会の実効性を高めるべく、実効性評価・アンケートを実施

指名・報酬諮問委員会

- 取締役会・監査等委員会から諮問を受けて、答申を行う
- 役員の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、原案に基づいて決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行う

サステナビリティ委員会

- SDGs活動方針(「環境問題への対応」「質の高い教育の提供による人材育成」「地域・社会への貢献」)に基づき月1回開催
- 企業価値の向上を通じて持続可能な社会の実現を目指し活動中

知的財産委員会

- 知的財産の投資については特許の申請や当社及び他社の特許の侵害がないかについてチェックをし、積極的に取り組みを実施

取締役報酬

- 当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。

今後の取組み

- 政策保有株式の縮減
- 女性取締役比率の増加

取締役会スキルマトリックス

地位・氏名		企業経営 経営戦略	国際事業 海外知見	財務戦略 会計	技術・品質 ・環境	人材開発・ ダイバーシティ	ガバナンス・コンプ ライアンス・ リスク管理	法的リスク 管理・法令遵守
代表取締役社長	武藤 公明	●	●	●	●	●	●	●
常務取締役管理担当	山畑 喜義	●		●		●	●	●
取締役足利工場長	小野塚 隆	●	●		●	●	●	●
取締役営業本部長	柏瀬 高志	●	●		●	●	●	
取締役生産本部長	関谷 高志	●	●		●	●	●	
取締役監査等委員	森田淳一郎	●		●		●	●	●
取締役監査等委員	政木 道夫	●					●	●
取締役監査等委員	青木 眞徳	●	●		●	●	●	

INDEX

1 当社の経営戦略について

- 会社概要
- 当社を取り巻く環境
- 事業戦略・資本戦略・サステナビリティ

2 2024年3月期 決算概要

3 2025年3月期 通期業績予想

売上高

前年対比

26.6%増

国内外の半導体シリコン
ウエーハ加工用の需要が
堅調に推移

営業利益

前年対比

42.2%増

営業利益率が9.8%と
前年対比で+1.1pt

経常利益

前年対比

47.4%増

親会社株主に帰属する
当期純利益

前年対比

8.9%増

前年同期から増加も、法人税
等の増加により前年からの
上昇率は限定的

単位:百万円

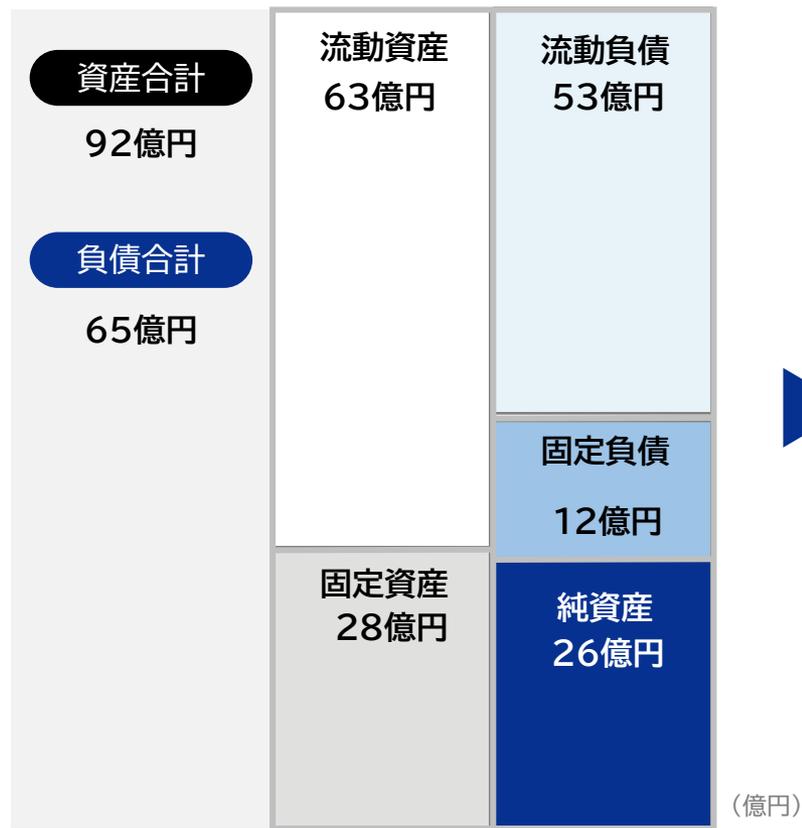
	23年3月期実績	24年3月期実績	増減(前年対比)
売上高	6,916	8,755	26.6%
営業利益	604	859	42.2%
営業利益率	8.7%	9.8%	1.1pt
経常利益	584	861	47.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	641	698	9.0%

単位:百万円

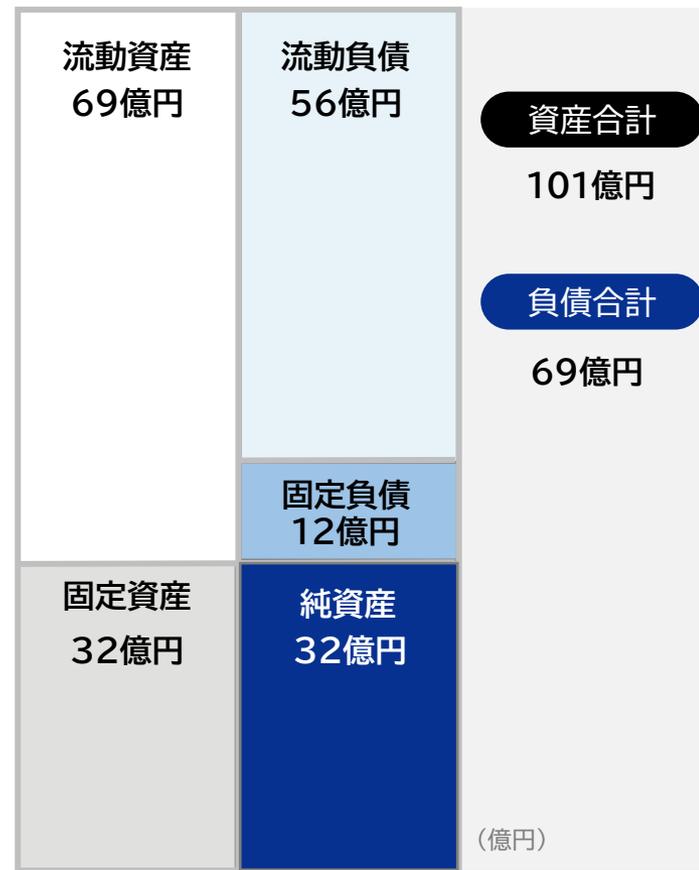
事業セグメント		23/3期	24/3期	前期比	増減率
ラップ盤	売上高	3,334	5,824	2,490	74.6%
	限界利益	1,228	1,911	683	55.6%
ホブ盤・フライス盤	売上高	1,504	1,019	▲485	▲32.2%
	限界利益	673	467	▲206	▲30.6%
部品・歯車	売上高	2,077	1,892	▲185	▲8.9%
	限界利益	—	—	—	—

(注)上表は単体でのセグメント別売上高・限界利益を記載

2023年3月末



2024年3月末



	23/3期	24/3期	増減
期首残高	1,397	1,189	▲208
営業C/F	521	162	▲359
投資C/F	▲66	▲133	▲67
財務C/F	▲666	▲203	463
期末残高	1,189	1,016	▲173
増減額	▲208	▲173	35

単位:百万円

INDEX

1 当社の経営戦略について

- 会社概要
- 当社を取り巻く環境
- 事業戦略・資本戦略・サステナビリティ

2 2024年3月期 決算概要

3 2025年3月期 通期業績予想

今後の見通し

- コロナ禍からの経済活動の再開に伴い、工作機械の受注は全体的に回復基調で推移
- しかし、引き続き部材が逼迫しており、リードタイムの伸びが特に中小型機に影響。単年度の業績は一定程度ボラティリティが発生する見込み

製品別取組み

- ラップ盤については、半導体シリコンウエハー加工用やSiC等のパワー半導体ウエハー、及び光学関連部品加工用、自動車部品などの金属部品加工用ファインラインディンクマシン等の拡販に引き続き注力
- ホブ盤については、加工対象物の自動脱着装置付新型ホブ盤等を市場投入し、釣具関連部品、電動工具用歯車、各種減速機歯車、およびEV歯車加工用等の販売を一層強化

単位:百万円

	23年3月期実績	24年3月期実績	前期比
売上高	6,916	8,755	26.6%
営業利益	604	859	42.2%
営業利益率	8.7%	9.8%	1.1pt
経常利益	584	861	47.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	641	698	9.0%



	25年3月期通期予想	前期比
	8,500	▲2.9%
	780	▲9.2%
	9.2%	▲0.6pt
	800	▲7.2%
	560	▲19.9%

単位:百万円

事業セグメント		23/3期	24/3期	25/3期	前期比
ラップ盤	売上高	3,334	5,824	5,700	▲124
ホブ盤・フライス盤	売上高	1,504	1,019	1,036	17
部品・歯車	売上高	2,077	1,911	1,764	▲147

ご注意

本資料は、当社の業績動向及び事業内容について、当社による現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しております。

業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しのみにより投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。

本資料における将来の展望に関する表明は、本資料開示時点(2024年5月28日現在)において利用可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して、将来の展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するものではございません。

お問合せ

T E L : 03-3491-0131(代表)

E-mail : hamai.ir@hamai.com

問合せ先責任者: 常務取締役管理担当 山畑 喜義